



XCVM1302-2LLEVSVD1760

Număr parc	XCVM1302-2LLEVSVD1760	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	AMD Xilinx	Starea stocului	11 pcs stock
Descriere produs	IC VERSALPRIME ACAP FPGA 1760BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

11 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs

\$2,914.686

Obțineți o ofertă

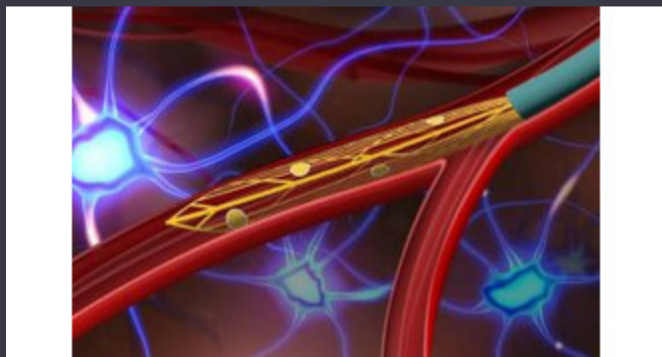
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XCVM1302-2LLEVSVD1760

Pachetul dispozitivului furnizor	1760-FCBGA (40x40)	Viteză	450MHz, 1.08GHz
Serie	Versal™ Prime	Dimensiunea RAM	-
Atributele primare	Versal™ Prime FPGA, 70k Logic Cells	Periferice	DDR, DMA, PCIe
Pachet / Caz	1760-BFBGA, FCBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	0°C ~ 100°C (TJ)	Numărul de intrări / ieșiri	402
Dimensiune bliț	-	Procesor Core	Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-
Conectivitate	CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG	Arhitectură	MPU, FPGA

Vești înrudite



Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare

2023/08/21

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Borgwarner primește puterea sic de la ST, precum și Onsemi

2023/08/31

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5